

○第 19 号

1 調達内容

- (1) 品目分類番号 71、27
- (2) 購入等件名及び数量
低コストチップ間インターフェース要素回路テストチップ設計 一式
- (3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。
- (4) 履行期限 令和7年3月21日
- (5) 履行場所 東京大学大学院工学系研究科
- (6) 第16号に同じ

2 競争参加資格

- (1)(4)(5) 第16号に同じ
- (2) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）において令和6年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。なお、当該競争参加資格については、令和6年3月29日付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。
- (3) 調達特定役務に係る迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。

3 入札書の提出場所等

- (1)(2) 第16号に同じ
- (3) 書類の受領期限 令和6年8月21日17時00分
- (4) 入札、開札の日時及び場所 令和6年9月11日15時00分 電子入札（リバースオークション）

4 その他

- (1)(2)(4)(5)(7)(8) 第16号に同じ
- (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した特定役務を履行できることを証明する書類を3(3)の書類の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、総長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
- (6) 落札者の決定方法 本公告に示した特定役務を履行できると総長が判断した入札者であって、国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

5 Summary

- (1)(8)(9) The same with the Notice above (No.16)
- (2) Classification of the services to be procured : 71, 27
- (3) Nature and quantity of the services to be required : Design of Test Chip for Low-cost

Die-to-Die Interface Circuit Component 1 Set

- (4) Fulfillment period : By 21 March, 2025
- (5) Fulfillment place : Graduate School of Engineering, The University of Tokyo
- (6) Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
 - A D E The same with the Notice above (No.16)
 - B have the Grade A, Grade B or Grade C qualification during fiscal 2024 in the Kanto · Koshinetsu area in offer of services for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency,
 - C prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service for the procured services,
- (7) Time limit of the documents : 17:00 21 August, 2024